

产品碳足迹核查概述

该公司

和舰芯片制造（苏州）股份有限公司

中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星华街 333 号

制造地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星华街 333 号

报告

和舰芯片 8 寸晶圆产品碳足迹报告书

产品 / 功能单位

1 片 8 寸晶圆从摇篮到大门的产品碳足迹为：**368.67** 千克二氧化碳当量

该公司所提供的产品碳足迹计算及报告已经过 SGS 核查，其计算符合 ISO 14040:2006 环境管理 - 生命周期评价 - 原则和框架、ISO 14044:2006 环境管理 - 生命周期评价 - 要求和指南、ISO 14067:2018 温室气体排放 - 产品碳足迹 - 量化要求与指南。

此次核查基于上述组织于 2023 年 5 月 5 日提交的报告及其支持性材料，详情请见报告：2023/PCFV/C/0108。



签署

颁发日期：2023 年 5 月 29 日

绿色产品服务
自愿性产品认证中心

通标标准技术服务有限公司

中国上海徐汇区宜山路 900 号 B 座 11 楼 邮编 200233

t + 86 (0)21 6140 2666 f + 86 (0)21 6115 2359 www.sgsgroup.com.cn



和舰芯片 8 寸晶圆产品碳足迹报告书

产品/功能单位

1 片 8 寸晶圆从摇篮到大门的产品碳足迹为：368.67 千克二氧化碳当量

产品碳足迹资料概述如下：

申请者：	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司
申请者地址：	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星华街 333 号
制造地址：	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星华街 333 号
产品描述：	8 寸晶圆
数据收集：	该公司所提供的产品碳足迹计算及报告根据 2022.01.01-2022.12.31 的收集数据，已经过 SGS 核查。
计算方法：	经 SGS 核查该计算符合 ISO 14040:2006 环境管理 - 生命周期评价 - 原则和框架、ISO 14044:2006 环境管理 - 生命周期评价 - 要求和指南、ISO 14067:2018 温室气体排放 - 产品碳足迹 - 量化要求与指南。
系统边界：	经 SGS 核查，该计算按照生命周期评价的原则来计算产品从摇篮到大门的碳足迹。
温室气体的计算：	二氧化碳当量值是按其单位辐射强迫换算而成，换算时采用政府间气候变化专业委员会（IPCC 2021，表 7.SM.7）定义的 100 年全球增温潜势。温室气体已列于 IPCC 2021，表 7.SM.7。
SGS 报告号：	SGS/RMSC/2023/PCFV/C/0108

签署



颁发日期：2023 年 5 月 29 日
绿色产品服务
自愿性产品认证中心

